



**LE GROUPE SOITEC ANNONCE QUE SA TECHNOLOGIE DE COLLAGE DE
PLAQUES CONTENANT DES CIRCUITS EST DISPONIBLE EN PRODUCTION
ET POUR LE TRANSFERT INDUSTRIEL**

**La technologie Smart Stacking™ offre des solutions de production de capteurs d'image,
de circuits photoniques et d'applications d'intégration 3D au niveau de la plaque**

Bernin, France, le 26 mars 2009 — Le Groupe Soitec (Euronext Paris), premier fournisseur mondial de substrats innovants pour l'industrie micro-électronique, a annoncé aujourd'hui que sa technologie d'empilement de circuits Smart Stacking™ est disponible en production et pour le transfert industriel. Ce procédé industriel de la division Tracit de Soitec, permet de reporter une couche entière contenant les circuits sur une nouvelle plaque. La capacité à déplacer un circuit finalisé sur un autre support sans compromettre le rendement ouvre de nouvelles perspectives aux concepteurs. Aujourd'hui, Smart Stacking™ permet la production de capteurs d'image de haute performance, elle permettra aussi de réaliser bientôt toute une gamme de nouvelles applications photoniques, de circuits RF et à terme d'architectures de produits 3D plus complexes.

Pour dissocier la fabrication du circuit des besoins de l'application, Soitec a développé un procédé générique de report de couches minces contenant des circuits sur divers matériaux. La technologie Smart Stacking™ utilise des techniques de collage de plaques à basse température et d'amincissement, qui bénéficient du savoir-faire de production à fort volume de Soitec. La société annonce que différents types de plaques provenant de divers fonderies et fabricants de semi-conducteurs intégrés (IDM) mondiaux ont été traités avec succès pour prototypage et production dans sa chaîne de fabrication au standard mondial.

« En tant que fabricant de substrats aux capacités industrielles mondialement reconnues, fort d'une propriété intellectuelle éprouvée et de plusieurs années d'expérience, Soitec propose une approche unique avec sa technologie d'empilement de circuits Smart Stacking™ » précise Bernard Aspar, directeur de la division Tracit. « Pour les applications de moyen volume, nous offrons des services de fabrication d'empilement de circuits sur mesure alors que pour les applications à plus fort volume, nous estimons qu'il est plus intéressant de transférer le procédé adapté chez nos clients, leur permettant ainsi de simplifier leur logistique, leur temps de cycle et réduire leurs coûts. C'est la raison pour laquelle nous offrons ces deux options de fabrication ou de licence de technologie ».

Le Groupe Soitec a acquis Tracit (entreprise issue du célèbre centre de recherche CEA-Léti) en 2006. L'annonce d'aujourd'hui confirme l'intérêt stratégique de cette acquisition à forte complémentarité, ainsi que la stratégie générale du Groupe axée sur la fabrication en volume, la concession de licences et l'innovation par le développement de technologies de pointe.

Selon une étude récente sur les circuits intégrés 3D par *Yole Development*, entreprise indépendante d'étude et d'analyse du marché des semi-conducteurs, la demande de report de circuits au niveau de la plaque devrait connaître un taux de croissance important vers 2010/2011, principalement pour les applications de capteurs d'image. « Vers 2012, quand le marché de l'intégration de composants hétérogènes tels que mémoires, logiques, circuits imprimés d'alimentation et analogiques aura décollé, la technologie d'empilement de circuits de Soitec pourra simplifier la conception et la fabrication d'appareils avec des fonctions

hybrides et l'intégration de technologies, » déclare le Dr Eric Mounier, cofondateur de *Yole Development*.

À propos du Groupe Soitec :

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Uls et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr
Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

Contacts Presse - H&B Communication

Marie-Caroline SARO – claire FLIN

Tél. 01 58 18 32 44 / 06 70 45 74 37 – mc.saro@hbcommunication.fr